

Trias 企業メモ 2010-09-14

(6920 JASDAQ)レーザーテック株式会社
2010年6月期 決算説明会・フォローアップ取材サマリ

2010年8月17日開催のレーザーテック株式会社(以下、レーザーテック)の2010年6月期決算説明会、ならびに説明会後に行いました同社代表取締役社長 岡林理氏に対するフォローアップ取材の概要をご案内いたします。

【2010年6月期連結決算概要】

【表1】にある通り、2010年6月期の連結売上高は、前年同期比3.6%減の8,931百万円、営業利益746百万円となった(前年同期は657百万円の赤字)。減収ながら黒字に転換した背景には、売上総利益率が9.5%改善したことに加え、販管費率が5.9%減少したことが大きい。粗利率については、技術部各部長が開発プロジェクトごとの採算管理を強化していることや、部門別原価・経費管理システムによる予実管理の精度が上がってきていることによる。費用面では、案件の絞込みによるメリハリのある開発に加え、開発組織の一元化による開発のスピードアップへの取組みが奏功した。結果、2月1日付の予想に対し、売上高は未達となったものの、営業利益以下、利益については大きく上回る事ができた。

【表1】 連結決算概要 ※各表とも、レーザーテック(株)の開示データに基づき、(株)トリアスにて作成

連結 (百万円)	FY6/09		FY6/10		対前期同期		FY6/10予 (2月1日付)
		構成比		構成比	増減額	増減率	
売上高	9,266	100.0%	8,931	100.0%	△ 335	-3.6%	9,700
売上総利益	2,654	28.6%	3,404	38.1%	750	28.3%	3,444
販管費及び一般管理費	3,311	35.7%	2,657	29.8%	△ 654	-19.7%	3,014
営業利益	△ 657	-7.1%	746	8.4%	1,403	n.a.	430
経常利益	△ 659	-7.1%	714	8.0%	1,373	n.a.	370
当期純利益	△ 651	-7.0%	361	4.0%	1,012	n.a.	200
研究開発費	1,242	13.4%	924	10.3%	△ 318	-25.6%	1,085
減価償却費	471	n.a.	354	n.a.	△ 117	-24.8%	386
設備投資額	54	n.a.	27	n.a.	△ 27	-50.0%	44
従業員数(除 役員)	240	n.a.	229	n.a.	△ 11	-4.6%	230

製品別動向については、【表2】に見られるとおり、半導体関連装置が受注高、売上高ともに大きく伸長した。これは、半導体の微細化投資などの回復により、受注が大きく伸びたことによる。前期の発表で、既に売上に貢献し始めている製品としては、フォトマスク欠陥検査装置 MATRICS シリーズの最先端機種「X700」(2009年9月発表)、卓上型太陽電池変換効率分布測定機「MP15」(同9月)、PC パーツ反り/3D プロファイル検査装置「PSK380」(同11月)、SiC ウェハ欠陥検査レビュー装置「SICA61」(同12月)がある。「X700」以外は、新規分野における開発品だが、「MP15」、「SICA61」とも、開発決定から発表に至るまでの期間は半年以内と、開発期間の大幅短縮を実現した。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

一方、FPD 関連装置については、受注高は対前年同期で伸長したが、売上高は半減、受注残高が増えた状態にある。この背景には、売上計上が検収基準であるため、液晶用カラーフィルター検査装置などには出荷しているものの未検収で売上計上に至っていない案件があること、FPD 関連装置のもう一つの柱である液晶用大型マスク検査装置の第 10 世代以上の投資が韓国や台湾でまだ始まっていないことなどがある。

【表2】製品別 売上高・受注動向

連結 (百万円)	2009年6月期			2010年6月期					
	受注高	売上高	受注残高	受注高	前年 同期比	売上高	前年 同期比	受注残高	前年 同期比
半導体関連装置	2,638	2,839	1,514	4,821	82.8%	5,142	81.1%	1,192	-21.2%
FPD関連装置	1,292	4,919	3,567	2,932	126.9%	2,432	-50.5%	4,067	14.0%
レーザー顕微鏡	467	599	46	333	-28.7%	369	-38.3%	9	-78.8%
サービス	935	908	113	1,027	9.8%	986	8.6%	154	36.6%
合計	5,334	9,266	5,240	9,115	70.9%	8,931	-3.6%	5,424	3.5%

【レーザーテックを取り巻く事業環境】

レーザーテックの主要事業ドメインは、半導体と液晶パネル関連の検査・測定装置市場だが、液晶パネルについては、TVの大型化、高画質化、3D、或いはスマートフォンなどの新技術・新アプリケーションによる市場拡大に加え、中国など新興市場での需要が拡大している。今後の液晶パネル製造のための大型投資は、中国でのパネル工場新規投資と韓国での第 8.5 世代の増強投資が中心になると見られる。ただし、TV をはじめ、最終製品市場での継続的、かつ激しい価格競争や価格下落圧力が、設備投資環境を厳しいものになっている。

一方、半導体市場では、家電や自動車向けなどの最終製品の高性能化、低価格化に対応し、高集積化や小型化が進んでいる。また、リーマンショック後の景気回復やタブレット PC などの新アプリケーションの拡大で、市場は回復基調にあり、デバイスメーカーは先端技術の開発や先端デバイスの生産能力増強に向けての投資を活発化している。一方、先端デバイスの製造ライン建設には膨大な投資や資本力が必要であること、また技術的な難しさがあることに加え、市場構造の変化、すなわち IDM(Integrated Device Manufacturer: 垂直統合型半導体デバイスメーカー)が 45nm 以降の製造ラインは自社で持たず、ファブリーに委託するという分業体制が進んでいることから、先端デバイスの開発・製造は、トップグループ企業群に集約されてきている。このように、プレーヤーの数が集約されてきたということは、反面、限られた市場での競争激化が避けられない。

このような環境下、レーザーテックでは、半導体、ならびに半導体関連の新規分野向け事業に経営資源を集中している。市場をどのようにとらえ、いかに戦うかという視点で、強みを発揮でき、かつ「成長できる分野」への特化—すなわち、市場成長が大きい分野＝新規市場と、強みを活かしシェア拡大を図れる分野＝既存市場を分けて事業展開を行うとともに、差別化が可能なニッチ領域への特化に注力している。

【新規市場における取り組み】

新規市場では、これまでどおり、世界標準を狙う。そのためには、中核となる技術を融合し、それをいち早く形にするスピードが必須と考える。以下、新規市場における世界標準に向けての現在の取組みを紹介する。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

TSV(シリコン貫通電極)プロセス開発: CNSE(ニューヨーク州立大学アルバニー校のナノスケール科学工学カレッジ)でSEMATECH(米国半導体工業会が中心となって1987年に発足した、官民共同による半導体製造技術研究組合)が行っている、半導体3次元積層技術プログラムに参加。このプログラムでは、3次元積層に重要なTSV(シリコン貫通電極)のプロセス開発を行っている。

太陽電池変換効率分布測定機: レーザーテックにとって新市場である太陽電池市場向けに、CT(コンピュータトモグラフィ: コンピューター断層撮影法)技術を応用した太陽電池変換効率分布測定機MPシリーズを開発。この測定器は、セル全面、あるいは特定箇所での変換効率分布の測定を可能にするシステムで、この分野での業界標準を狙いたいと考えている。

SiC(炭化ケイ素)ウェハ(基板)欠陥検査レビュー装置: 電気自動車やエアコンなどには、パワーデバイスという直流から交流などへの電力変換デバイスが使用されているが、パワーデバイスの素材として従来使われてきたシリコンは消費電力の損失が大きいという課題があった。これに対しSiCは、シリコンに比べて電力損失を数分の1に抑える効果があり、実用化が進んでいるが、SiCウェハ上の極めて微小な欠陥をしっかりと検出できる装置がなかった。レーザーテックでは、コア技術のコンフォーカル光学系技術に微分干渉技術を組み合わせた新たな検査方法を用い、ウェハ上の数nmレベルという微小なへこみ欠陥も検出できる装置、SiCウェハ欠陥検査レビュー装置SICA61を開発、すでに納入が始まっている。

【既存市場における取組み】

既存市場については、技術・製造プロセスの最先端の技術革新を先取りすることや、顧客ニーズにあったカスタマイズが重要になる。例えば、半導体フォトマスク欠陥検査装置の領域は、市場の拡大とともに性能を重視したコストパフォーマンスが評価される。2006年11月の発表以来、着実に市場シェアを伸ばしているMATRICSシリーズは、半導体の微細化と顧客メーカーの高度化する要求に対応することで、差別化を実現してきた。新製品MATRICS「X700」は、独自の光学系開発により、キズ欠陥や露光工程でフォトマスクに発生するヘイズと呼ばれる成長性異物の検出感度を大きく改善させ、新たな顧客開拓が進んでいる。

現在、顧客サイトで評価が始まっている新製品、ヘイズ除去システム「PROMAHAZE」との併用により、露光工程でフォトマスクに発生するヘイズをMATRICSで検出、検出されたヘイズを「PROMAHAZE」で除去する。MATRICS「X700」と「PROMAHAZE」の組み合わせは、顧客サイトでの検出から除去までを可能にするため、半導体メーカーのトータルコストの大幅な改善に寄与できると期待している。「PROMAHAZE」については、顧客メーカーのプロセス毎に様々な評価が必要なため、受注獲得にはもう少し時間がかかる見通しだが、価格面でも、システムとしてのトータルな性能面でも、競合に対し優位性を十分実現できると考えている。

【2011年6月期連結業績予想】

2011年6月期の連結業績予想の概要は、【表3】～【表5】にある通り。半導体関連装置は、引き合いの強いMATRICS「X700」を中心に、その他新製品の受注が上期に積み上がり、下期の売上につながる見通しだ。FPD関連装置は、カラーフィルター検査修正装置を中心に、同じく上期に受注が積み上がり、売上は今下期、あるいはそれ以降になると見込んでいる。上期は受注活動を強化するとともに、納期短縮を図り、最も売上が拡大するQ4に向け、刈り取りを計画している。ちなみに、4半期ごとの売上推移は、Q1が3億円、Q2 35億円、Q3 20億円、Q4 67億円と予想。受注は主に海外からと予想しており、海外比率は約74%と見込む。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【表3】連結決算予想

連結 (百万円)	FY6/10		FY6/11予				対前期同期	
	実績	構成比	上期	下期	通期	構成比	増減額	増減率
売上高	8,931	100.0%	3,800	8,700	12,500	100.0%	3,569	40.0%
営業利益	746	8.4%	△ 350	1,750	1,400	11.2%	654	87.5%
経常利益	714	8.0%	△ 400	1,700	1,300	10.4%	586	82.0%
当期純利益	361	4.0%	△ 250	1,100	850	6.8%	489	135.1%
研究開発費	924	10.3%	n.a.	n.a.	1,423	11.4%	499	54.0%
減価償却費	354	n.a.	n.a.	n.a.	318	n.a.	△ 36	-10.2%
設備投資額	27	n.a.	n.a.	n.a.	80	n.a.	53	196.3%
従業員数(除 役員)	229	n.a.	n.a.	n.a.	235	n.a.	6	2.6%

【表4】製品別売上高予想(半期ごと)

連結 (百万円)	2010年6月期 (実績)				2011年6月期 (予想)				
	上期	下期	通期	構成比	上期	下期	通期	構成比	対前年同期比
半導体関連装置	1,905	3,237	5,142	57.6%	2,560	4,400	6,960	55.7%	35.4%
FPD関連装置	1,079	1,353	2,432	27.2%	570	3,580	4,150	33.2%	70.6%
レーザー顕微鏡	154	215	369	4.2%	200	160	360	2.9%	-2.4%
サービス	520	466	986	11.0%	470	560	1,030	8.2%	4.5%
合計	3,660	5,271	8,931	100.0%	3,800	8,700	12,500	100.0%	40.0%

【表5】製品別受注高予想(半期ごと)

連結 (百万円)	2010年6月期 (実績)				2011年6月期 (予想)				
	上期	下期	通期	構成比	上期	下期	通期	構成比	対前年同期比
半導体関連装置	2,433	2,388	4,821	52.9%	6,380	3,670	10,050	67.0%	108.5%
FPD関連装置	704	2,228	2,932	32.2%	2,350	1,210	3,560	23.7%	21.4%
レーザー顕微鏡	211	122	333	3.7%	200	160	360	2.4%	8.1%
サービス	551	476	1,027	11.3%	470	560	1,030	6.9%	0.3%
合計	3,900	5,215	9,115	100.0%	9,400	5,600	15,000	100.0%	64.6%

【Q&A】 ※ 一部、取材時の質疑の内容も含まれます。

Q. MATRICSシリーズの今後の見通しについて。受注の持続性はあるのか？

A. 半導体デバイスに回路パターンを焼き付ける露光技術では、微細化に伴い、193nm 波長の ArF エキシマレーザーによる露光が一般的になっている。しかし、ArF 露光では、露光を繰返すに伴い、フォトマスクの表面にヘイズと呼ばれる成長性異物が発生し、これが歩留り低下という大きな問題につながっている。このため、歩留まりが低下する前にヘイズを検出するための検査ニーズがますます高まっている。こうした要望に応じて開発したのが MATRICS の「X700」シリーズだ。すでにフォトマスクの検査では、MATRICS の一号機「X600」で顧客満足を得ているが、微細化の進展やヘイズという新たな重要課題の発生で、次世代機へのニーズがあり、「X700」を開発した。「X700」は、メモリーのみならずロジック半導体にも向いて

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

おり、既に大手メモリーメーカーや大手ファブリーなどに納入を開始している。今後、生産ラインの増強に伴う投資や新たな顧客開拓で、受注の持続性はあると考えている。

Q. 2011年6月期業績予想について、過去に比べ、マスクブランクス検査装置の売上予想が低いのは何故か？

A. 半導体関連で、MATRICS と並び、売上のもう一つの柱である MAGICS(マスクブランクス欠陥検査装置)は、2009年6月期から2010年6月期の2期にわたり投資が大きく増えたが、今は投資は一服している。顧客メーカーによる投資サイクルを考慮し、MATRICS 以外の既存製品の売上については慎重に見ている。尚、現在主力になりつつあるArF液浸方式の露光波長193nmに対し、露光波長が1/10以下となり、さらに微細な線幅の回路を実現すると期待されている次世代露光技術、EUVL(極端紫外線露光)についても、2013年の量産ロードマップにあわせて対応準備を進めており、2012年6月期には次世代EUVLに向けた投資が新たに始まるものと見ている。☞

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【ご参考】

(6920)レーザーテック株式会社

連結主要指標と業績の推移

連結主要データ		
発行済み株式数(株)	2010.6月	11,785,800
うち自己株式数(株)	2010.6月	522,727
時価総額(百万円)	2010.9.14	10,077
一株当純資産(円)	2009.6月	1,075.5
ROE(%)	2009.6月	3.0
ROA(%)	2009.6月	1.9
PER(倍)	2011.6月予	11.3
PCFR(倍)	2009.6月	14.1
PBR(倍)	2009.6月	0.8
株価(円)	2010.9.14	855
単元株数	2010.6月	100
日々平均出来高	2010.9.14	34,400

連結主要データ		
総資産(百万円)	2009.6月	18,885
自己資本(百万円)	2009.6月	12,113
有利子負債(百万円)	2009.6月	4,000
自己資本比率(%)	2009.6月	64.1
有利子負債比率(%)	2009.6月	33.0
フリーキャッシュフロー(百万円)	2009.6月	△ 2,213

注: ROE=当期純利益÷期首と期末の自己資本の平均

ROA=当期純利益÷期首と期末の総資産の平均

PCFR=時価総額/(当期純利益+減価償却費)

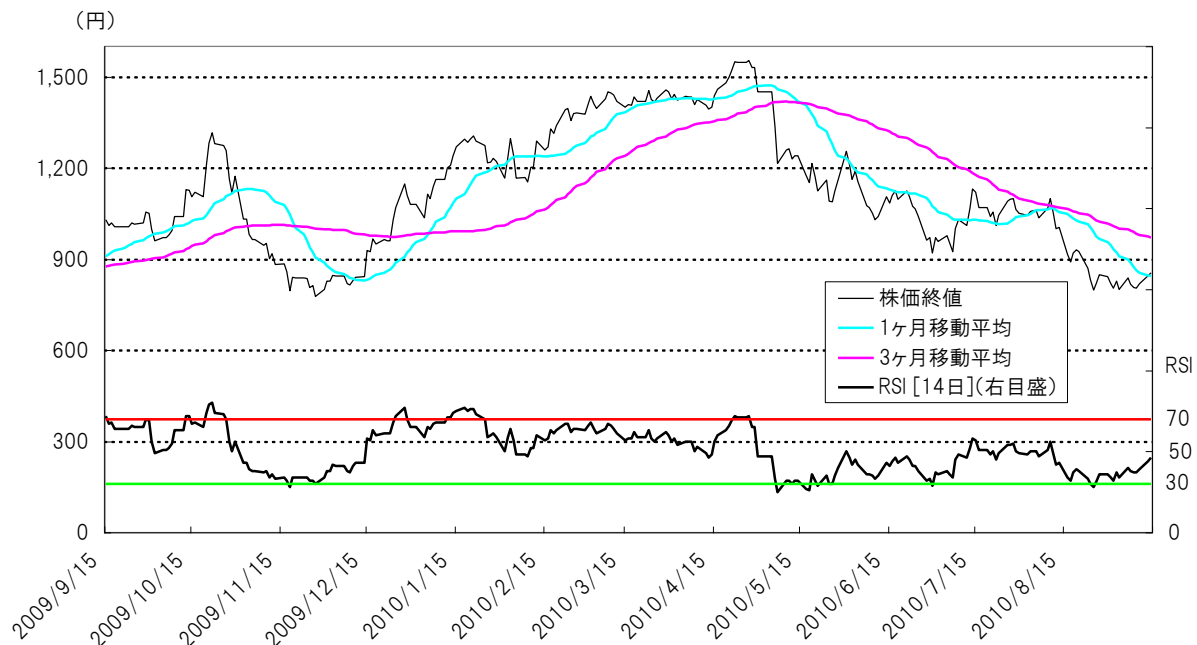
日々平均出来高=過去1年間の平均

有利子負債比率=有利子負債÷自己資本

フリーキャッシュフロー(FCF)=営業CF+投資CF

連結(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益	1株益(円)	希薄化後1株益	1株配(円)
2007年6月期	15,874	3,895	3,895	2,375	203.80	n.a.	60.00
2008年6月期	14,136	3,100	3,156	1,888	165.20	n.a.	50.00
2009年6月期	9,266	△ 657	△ 659	△ 651	-57.82	n.a.	15.00
2010年6月期	8,931	746	714	361	32.10	26.31	15.00
予2011年6月期第2四半期	3,800	△ 350	△ 400	△ 250	-22.19	-	-
予2011年6月期	12,500	1,400	1,300	850	75.48	-	23.00

注 2011年6月期予想は、2010年8月13日発表の会社予想

株価チャートとRSI


出所: Bloombergのデータを基にトリアス作成

注: RSI(Relative Strength Index)とは株価の「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」を指数で表したもので、一般的にRSIが70を超えると高値圏、30以下では安値圏に位置していると言われている

$$RSI = \frac{N \text{日間の値上がり幅平均}}{N \text{日間の値上がり幅平均} + N \text{日間の値下がり幅平均}} \times 100$$

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。